

主催：（日本側）岩手大学分子接合技術研究センター
（台湾側）三建産業情報社（SUMKEN）

共催：i-SB事業化プラットフォーム

（運営主体：岩手大学、岩手県、岩手県工業技術センター、いわて産業振興センター）

後援：INSポリマー研究会、東北ポリマー懇話会

次世代半導体パッケージ に関するセミナー

日本台湾半導体交流セミナー

日本企業と台湾企業の交流を目的とする、次世代半導体パッケージに関するセミナーです

2024

5/16 (Thu)

14:00-18:10 (JST)

オンライン（逐次通訳つき）

1) AI製品による認証プロセスおよび設計事例

元UL Solutions Taiwan 陳立閔 (Benjamin Chen)

2) 先端的な半導体3Dパッケージング技術の現状と今後の展開

国立台湾科技大学 客員教授 (元鴻海精密工業) 賴文政 (Wen-Cheng Lai)

3) 半導体パッケージ材料の開発動向

味の素ファインテクノ (株) 研究開発部 マネージャー 依田 正応 (Masanori Yoda)

事前申込制・申込期限

5/10 (Fri)

下記URLまたはQRコードを読み込んで
お申し込み下さい。

<https://forms.gle/XbAzkHsNE4BMQezd7>



・セミナー前日にミーティングリンクを送付します。

岩手大学分子接合技術研究センターは、i-SB事業化プラットフォーム運営主体の中核組織として、分子接合技術（i-SB法®）と樹脂精密設計技術のものづくり分野における幅広い普及と、それによるプロセスと製品のイノベーション創出を目指す活動を展開しています。

問い合わせ先

岩手大学 分子接合技術研究センター事務局（岩手大学 研究・地域連携課）



isb-office@iwate-u.ac.jp



<https://www.iwate-u.ac.jp/academics/facility/mbt.html>